

シリコンカーバイド (SiC) 用スラリー

低欠陥のパワーSiC (シリコンカーバイド) 基板および半絶縁性 SiC 基板の量産に対応した高性能スラリー

インテグリスは、SiC (シリコンカーバイド) 研磨スラリーのマーケットをリードしています。インテグリスのスラリーは、Si 面、C 面あるいは poly-SiC ウェーハにおいて、ラッピングプロセスから CMP プロセスまでのさまざまな基板製造プロセスにおける仕様を満たすように設計されています。バッチ式および枚葉式ウェーハ CMP 装置向けに最適化されたソリューションにより、コストオペレーティングの低減を実現します。また、先進的なスラリーの配合により、均一性、サブサーフェスのダメージゼロ、および低欠陥/低スクラッチを保ちつつ、既存の研磨プロセス速度よりも最大 10 倍の超高速研磨率を実現します。さらに、薬液供給システムとの互換性があり、大量生産 (HVM) にも対応しています。お客様のご要望に応じて、カスタムメイドが可能です。

アプリケーション

- シリコンカーバイド (SiC) の CMP/ラッピング
- すべての表面タイプ (ラッピング、機械研磨、または粗研磨) をエピレディ状態に研磨

特長と利点

高性能スラリー	サブサーフェスのダメージゼロと優れた安定性および分散性を両立しつつ、高い研磨レートを実現
スラリーの安定性、洗浄効率性、およびフィルム特性	量産の拡大が可能
グローバルな製造機能	お客様にできるだけ近い場所での納期対応とカスタムメイドのソリューションを提供
お客様とのコラボレーション	最前線のお客様のアプリケーション要件を基にスラリーを開発 インテグリスのアプリケーションエンジニアがお客様と協力して、目標とするパラメーターとプロセス条件を確認し最適化



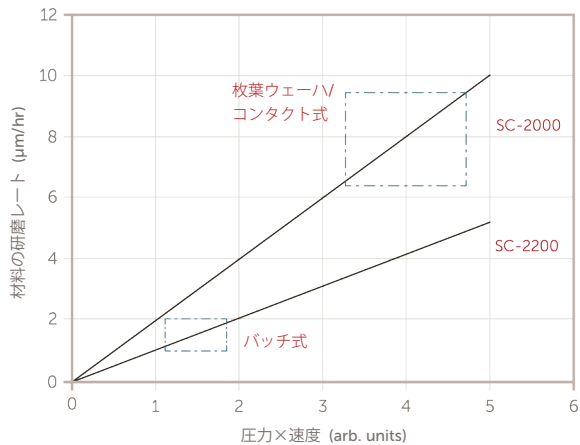
SiC ウェーハのラッピングおよび機械研磨に特化して設計されています。

仕様

スラリー	プロセス	最適な研磨面	主な特長	研磨レート (MRR)
バッチ式装置用スラリー、AFシリーズ、SC1Tシリーズ	バッチ用 CMP	Si 面	バッチ式装置用 CMP スラリーの業界標準 バッチ式研磨装置向けにコストパフォーマンスを最小限に抑つつエピレディな面の品質が実現できるよう最適化	1.5 ~ 2.5 $\mu\text{m/hr}$
枚葉式ウェーハ用 CMP スラリー、CS GS シリーズ、SC200 シリーズ	枚葉式ウェーハ用 CMP	Si 面	低欠陥でエピレディな表面仕上げを実現する超高速研磨が可能なスラリー 6 インチおよび 8 インチ SiC 基板用のさまざまな CMP プラットフォームにおいて、コストパフォーマンスで市場をリードしている枚葉式研磨装置に対して最適化	8 ~ 10 $\mu\text{m/hr}$
Poly-SiC 用スラリー、SC3000 シリーズ	Poly-SiC 基板向けのバルクおよび仕上げ用 CMP	Poly-SiC	特別に設計された高度な粒子と配合薬品で、Poly-SiC 基板における高い研磨レートと最小の表面粗さを提供	2 ~ 5 $\mu\text{m/hr}$

性能データ

シリコンカーバイド用 CMP スラリー



詳細情報

詳細情報および最新情報については、インテグリスまでお問い合わせください。www.entegris.com の「[お問い合わせ](#)」ページから最寄りのインテグリスをご確認いただけます。

販売条件

全ての購入は、インテグリスの「販売条件」に従うものとします。この情報を閲覧および印刷するには、インテグリスの「販売条件 (Entegris Terms and Conditions of Sale)」は、www.entegris.com のホームページのフッターにある「[販売条件](#)」をクリックしてください。



日本インテグリス合同会社

本社 | 〒 108-0073 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビルヂング TEL (03)5442-9718 FAX (03)5442-9738

Entegris®, Entegris Rings Design®, およびその他の製品名は Entegris, Inc. の商標です。詳細は www.entegris.com の [規定/商標](#) をご覧ください。全てのサードパーティの製品名、ロゴ、企業名、商標、登録商標は、それぞれその所有者に帰属します。それらの使用は、商標権所有者との提携、同者による支援、推奨を示すものではありません。

©2021-2022 Entegris, Inc. | All rights reserved. | Printed in the USA | 9000-11144ENT-0422JPN